

中信建投证券股份有限公司
关于上海南芯半导体科技股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称： 中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称： 上海南芯半导体科技股份有限公司
保荐代表人姓名：贾兴华	联系方式：021-68801554 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
保荐代表人姓名：杨鑫强	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

2023 年 4 月 7 日，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“南芯科技”、“公司”）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为南芯科技的保荐机构，对南芯科技进行持续督导。2024 年上半年度（以下简称“本报告期”），中信建投证券对南芯科技的持续督导工作情况总结如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与公司签订持续督导协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对公司开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，公司未发生按有关规定需公开发表声明的违法违规事项。

序号	工作内容	持续督导情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等	本持续督导期间，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	本持续督导期间，保荐机构已督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	本持续督导期间，保荐机构已督导公司依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	本持续督导期间，保荐机构对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	本持续督导期间，保荐机构已督导公司严格执行信息披露制度，并审阅其向上海证券交易所提交的信息披露文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告； 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或	在本持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未出现该等事项。

序号	工作内容	持续督导情况
	者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，公司未出现该等事项。
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形	本持续督导期间，公司未出现该等事项。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求。本持续督导期间，公司未出现该等需开展专项现场检查的事项。
16	持续关注上市公司的承诺履行情况	本持续督导期间，公司不存在未履行承诺的情况。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）宏观经济、行业弱复苏与需求不足风险

近年来，半导体行业经历了从供应链驱动向需求驱动的转变，与全球经济形势紧密相连。面对地区冲突、政治动荡、通货膨胀和美元高利率等挑战，这些因素共同制约了全球经济的增长和市场需求。尽管行业正处于去库存周期的尾声，模拟芯片市场开始显露出复苏迹象。公司将密切监控产业链的动态，深化与客户的沟通以精准捕捉市场动向，同时积极扩展产品线，探索新的潜力大客户，并加强市场情报的搜集与分析，以减轻需求波动对公司运营的潜在影响。

（二）行业竞争风险

模拟芯片行业在全球范围内分布着众多企业，其中 2023 年全球前五大厂商共占有约 52% 的市场份额，显示出这一行业竞争格局的分散性和充分竞争的特性。目前，市场主要由 TI 等欧美厂商引领，它们在中国的高端模拟芯片市场占据主导地位，利用资本、平台和研发优势，对国内企业构成显著的竞争挑战。近两年，模拟芯片行业经历了去库存阶段，价格竞争尤为激烈。作为全球最大的模拟芯片消费市场，中国在技术创新和政策支持的推动下，展现出巨大的长期需求潜力。面对国际巨头的竞争，国内企业可能通过提供高性价比的产品来争夺市场份额，但这也可能对产品的利润率和现金流造成压力。展望后续，国内半导体行业会进入新的发展阶段，行业集中度将逐步提高，市场竞争将进一步加剧。

公司将继续以研发创新为核心动力，致力于为客户提供最优的解决方案，并通过差异化竞争策略来发挥自身优势。然而，公司如果不能持续维持技术创新和成本控制，有效应对行业的竞争，可能会面临市场份额和利润空间的缩减风险。

（三）经销模式下客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户集中度较高，公司客户主要为业内知名的电子元

器件经销商。

未来，若公司主要客户或终端品牌厂商的经营情况和资信状况发生不利变化，或目前主要客户经营、采购战略发生较大变化，或行业价格恶性竞争加剧，公司对主要客户的销售收入将存在一定不确定性，从而为公司的稳定盈利带来影响。此外，若部分主要客户需求减少，可能导致公司收入增速有所放缓甚至下滑。

（四）产品研发及技术创新风险

公司的产品主要应用于消费电子领域，消费电子行业变化快、市场窗口期短、竞争较为激烈，要求公司快速推出新产品，并跟随市场变化持续快速更新迭代。为了巩固竞争力，公司必须对市场动态和技术创新趋势保持敏锐的洞察力，不断优化成本结构，并灵活调整技术发展策略，以在产品质量、性能、效率和成本等方面保持优势。若技术研发跟不上行业升级的步伐，可能会导致资源浪费和错失市场机遇，进而对公司造成负面影响。

除了消费电子领域，公司还会持续加大在汽车电子和工业应用领域的研发力度。该等领域与消费电子领域存在显著差异，对电源管理芯片的性能、可靠性、稳定性和技术难度都有更高要求。因此，新产品的研发过程可能面临更多挑战和风险。公司需要在这些领域持续投入，以确保技术进步和市场竞争力。

（五）供应商集中度较高的风险

晶圆制造和封装测试是资本和技术密集型行业，市场集中度较高，能够满足公司技术和生产标准的供应商相对有限。公司目前主要晶圆供应商包括中芯国际、华虹集团等，主要封测供应商包括长电集团、华天集团等，集中度相对较高。

展望未来，如果公司的主要供应商遭遇地缘政治、经营困境、产能瓶颈或合作问题，或者整个产业链的景气度下降，这可能导致供应商无法保证充足的供应量和及时交付。此外，供应商可能会提出更高的价格、更严格的付款条件或更长的交货期限等不利的商业条款，这些都可能对公司的生产和经营活动产生负面影响。

（六）地缘政治风险

地缘政治的紧张局势对全球贸易环境产生了深远影响。在当前国际贸易紧张和贸易保护主义措施不断增加的背景下，中国的一些产业面临着发展制约。尽管公司一直恪守国内外法律法规，但快速变化的国际形势可能随时对公司的业务造成影响。特别是如果国际贸易争端导致业务运作受限、供应链中断或客户需求受限，公司的运营可能会遭受严重影响。

近年来，部分外国政府将一些产业链上下游的企业纳入“实体清单”，或通过其他限制措施，对中国的某些公司获取半导体技术和服务施加了限制。鉴于公司的部分供应商可能依赖于美国的设备和技术，地缘政治紧张局势的加剧可能会对供应商向公司供货或提供服务的能力造成限制，也可能对公司客户销售产品以及公司拓展国际客户施加阻力，进而对公司的业务运营产生负面影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年上半年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,250,095,791.84	660,459,657.09	89.28
归属于上市公司股东的 净利润	205,153,757.07	100,632,272.37	103.86
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	205,961,326.49	96,612,395.64	113.18
经营活动产生的现金流 量净额	267,419,631.52	165,199,190.00	61.88
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的 净资产	3,841,440,059.77	3,699,036,849.77	3.85
总资产	4,496,749,757.63	4,461,859,875.30	0.78

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.48	0.26	84.62
稀释每股收益（元 / 股）	0.48	0.26	84.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	0.49	0.25	96.00
加权平均净资产收益率（%）	5.45	4.35	增加 1.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	5.47	4.17	增加 1.30 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	14.61	18.88	减少 4.27 个百分点

2024 年上半年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

营业收入较上年同期增加 89.28%：主要系下游终端市场需求上升，销售收入增加所致。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 103.86%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 113.18%：主要系营业收入同比上升所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营业收入同比上升所致。

基本每股收益及稀释每股收益均较上年同期增加 84.62%：主要系净利润增加所致。

加权平均净资产收益率较上年同期增加 1.10 个百分点、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加 1.30 个百分点：主要系净利润增加所致。

研发投入占营业收入的比例较上年同期减少 4.27 个百分点：主要系报告期内公司营业收入同比增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）市场洞察与研发创新构筑公司竞争力内核

在当前竞争激烈的市场中，研发创新是推动公司持续发展的核心动力。公司深知，提供全面的解决方案必须基于对整个系统的深刻理解，这要求公司构建起一套独有的专有技术体系。公司通过从下游行业、终端产品领域视角，延伸至整个产品在电源管理领域的关键需求链条，深入理解客户的痛点，提供满足客户产品切实需求的解决方案，从而激发公司真正在产品设计上实现价值创造。

基于行业经验和对市场的敏锐洞察力，公司不断推动产品创新，积累了卓越的产品定义能力。研发团队能够迅速响应行业发展趋势和客户需求，制定与下游客户未来产品需求高度一致的研发路线图，通过对产品的不断创新迭代，引领行业标准，为客户创造了更具价值和竞争力的产品，也巩固了公司在市场中的领导地位。

公司具备较强的产品研发能力，产品应用领域已覆盖消费电子、汽车电子及工业领域，产品品类以充电管理、DC-DC 等为起点已逐步扩充至 AC-DC、电池管理、驱动芯片、车规级电源管理芯片及符合工业标准的电源管理芯片等。在智能手机有线充电管理芯片领域，公司具备全球行业最领先的技术水平及市场竞争力，在充电器 GaN 合封产品、Buck/Boost Charger 等方面具备行业创新和竞争优势。此外，公司在汽车电子领域持续加大研发投入，从车载无线有线充电产品切入知名汽车品牌，凭借快速迭代和持续创新能力，不断拓展新品类布局，在域控制器、智能座舱、ADAS、车身控制和 BMS 等领域开展产品布局规划。

公司长期以来坚持技术自主创新，对优势产品不断创新迭代，并持续强化产品矩阵，旨在为客户提供更高效、更优成本的综合解决方案，巩固自身竞争力。公司已累计获得专利 100 项，报告期内公司新增授权发明专利 11 项，专利覆盖充电管理、电池管理、升降压转换、整流控制、电源驱动等方面，涉及包括消费电子、汽车电子以及工业等产业领域。报告期内，公司持续加大研发投入，研发队伍继续壮大，今年上半年研发费用为 18,267.14 万元，较上年同期增长 46.47%；截至报告期末，公司研发人员数量增至 440 人，较上年同期增长 32.93%，研发人员数量占公司总人数比例为 64.90%，研发人员占比保持稳定。

（二）国内领先的拥有端到端完整方案解决能力的芯片设计厂商

公司在智能手机应用领域围绕最具竞争优势的有线充电管理芯片产品为核心，协同发展智能手机电源及电池管理全链路芯片业务机会，是国内领先的拥有端到端完整方案解决能力的芯片设计厂商。公司深度布局消费电子、汽车电子和工业等领域，持续围绕客户终端应用研发新产品，不断强化竞争力。

从供电端到设备端，公司广泛布局包括 AC-DC、充电协议、有线/无线充电管理、DC-DC、BMS、Display Power 等芯片产品，其中，公司继续保持以电荷泵为核心的有线充电管理芯片产品在市场中的竞争优势，能够提供覆盖支持从 10W 到 300W 的充电功率的充电解决方案，尤其是在高功率及超高功率段位的产品，公司具备最强劲的市场竞争力。

公司围绕以智能手机为代表的消费电子充电全链路领域，积极发挥设计、整合能力，不断扩充、优化产品线，为客户提供高效、高可靠性、高集成度的系统性解决方案。例如，公司推出的集成了多功能的有线充电管理芯片，包括协议通讯、电荷泵充电管理、主充电管理等功能，代表了行业内的领先水平，能更有效地帮助客户提高产品效能、优化成本；此外，在无线充管理芯片、锂电管理芯片、显示驱动芯片、DC-DC 芯片产品等方面也受到更多头部消费电子品牌厂商的认可。

在电源适配器领域，减小充电器体积、提高充电效率始终是行业发展的趋势。传统的多芯片设计整体走线冗长复杂，难以实现整机体积的极致压缩。因此，从最初的分立式控制到 GaN 合封，公司不断探索集成度更高的解决方案，更大限度发挥 GaN 器件的性能优势。公司积极发展自研集成化设计封装能力，推出应用在充电器中的全集成反激方案 POWERQUARK®，成功将原边控制器、高压 GaN、隔离通讯、次级 SR 控制器和协议这五种独立功能集成到同一颗芯片，大大简化了电路结构。此外，POWERQUARK® 还使用了高速、高可靠性的隔离数字通讯替代了传统的隔离光耦，大幅减少外围元器件数量，仅用一颗芯片和一个同步整流开关管即可实现电路功能，充电器体积大幅缩小，高集成度也带来了更高的效率。

（三）优质终端品牌客户的价值认可，合作共赢

公司依托卓越的技术创新和产品研发实力，不断为客户提供高价值和竞争力的产品，赢得了市场的广泛认可。目前，公司在消费电子领域的电源管理芯片产品已覆盖国内多家知名智能手机品牌厂商，特别是在以电荷泵为核心的有线充电管理芯片领域，竞争优势显著，在该等手机品牌的市场份额中位居第一。由公司推出的充电解决方案所赋能的国内各大品牌智能手机产品，在充电效率、可靠性及稳定性等方面已领跑全球市场。此外，公司正积极拓展海外品牌客户，以期为未来发展注入更多动力。

品牌客户在选择芯片供应商时严格谨慎，导入门槛较高，需经过长期产品审核和验证才能进入其供应链体系。公司高度重视自主研发和产品可控性，产品性能、品质及交付能力获得了客户的高度认可，并在客户的更多类型终端产品及应用环节中不断取得新突破。近年来公司获得了小米、OPPO、vivo、荣耀和联想等终端品牌客户颁发的多个奖项，这不仅是对公司产品质量和服务的价值认可，也反映了公司在行业中的领先地位。

公司通过提供完整的解决方案，帮助客户降低运营和采购成本，缩短产品开发周期，并赋能客户终端产品不断迭代创新。客户的新产品需求也不断激发公司的创新研发能力，形成了互相促进、共同发展的良性循环。通过优势产品的前期导入，带动全链路电源管理解决方案的应用，提升商业效率；系统级方案为客户的产品带来更高的可靠性和稳定性，也进一步增强了客户黏性，为公司构筑了更高的竞争壁垒。

围绕现有优质客户群体，公司积极拓展有线充电以外的消费电子领域电源管理芯片全链路产品。在电源适配器芯片方面增长速度较快，在无线充电、锂电管理、屏幕电源管理芯片等领域也持续取得突破性进展。随着品牌终端客户不断追求技术创新、需求市场竞争力，公司在服务过程中及时了解并满足客户的最新需求，保持了研发的前瞻性和产品的领先性。这不仅促进了公司产品从研发到落地的良性循环，也为公司的持续发展注入了源源不断的动力。通过与客户的紧密合作，公司能够实时应对市场变化，推动行业进步，引领行业趋势，实现共赢共成长。

（四）强化品质管控能力，赋予产品高可靠性

在品控管理层面，产品的兼容性、适配性和可靠性是终端设备性能和品质的关键。完整解决方案能够减少不同厂商之间的产品兼容及适配问题，从源头着手，通过深入分析终端设备的应用场景和需求，确保每一部分的产品都能满足高标准品质要求，这种从终端反向推导的方法，使公司能够更精准地识别和解决潜在的兼容性和适配性问题，提高产品的整体性能和减少客户的综合成本。相对应的，在全链路的产品中也要做到有效提高生产、测试、采购环节的品质管控及问责效率，从而最大程度保障终端设备稳定运行。通过这种全面的品质控制策略，不仅保障了产品的高标准质量，也为客户带来了更高的价值。

公司按照 TS16949 要求建立质量管理体系，产品质量获得国内多家知名终端厂商的认可和信赖。公司已成功完成 ISO 26262 功能安全管理体系最高等级认证 ASIL-D 等级的认证工作，整体产品质量体系迈向一个新台阶。

公司拥有丰富的第三方实验室资源，还积极投资建设自有测试实验室，通过对新产品研发过程中的关键节点定制专业化的测试流程，进行产品的可靠性和有效性分析，获得即时、精确、完整的反馈数据，最大限度地为产品研发保驾护航。公司已完成可靠性实验室二期的建设，随着实验室二期的投入使用，公司质量管理体系将持续升级。

（五）完善的供应链管理，提升综合竞争力

公司十分重视供应链能力的建设，在供应商选择上寻求与产业链领先的本土厂商合作，保障公司供应链自主可控。该等厂商不仅拥有稳定、成熟的生产工艺以保障产品的良率和一致性，与其有效的战略合作还能减少产能波动对公司产品交付及时性的影响。公司与头部的晶圆制造厂商、封装测试厂商等供应商建立了高效的联动机制和长期互信的合作关系，通过聚合订单、产能向头部供应商匹配，以获取更优的采购成本。

公司以 FOT 模式与 COT 模式相结合，拥有从工艺器件开发到 SPICE 模式和 PDK 的全流程自研能力；并与供应商积极合作，发展 BCD 特色工艺，同时具备多样化的封装工艺，逐步覆盖公司全部芯片产品。以满足公司产品设计创新的

需求，保持公司芯片产品在制造工艺和封装方面的领先地位，提升公司综合竞争力。

（六）战略路径贯穿产业机遇，持续完善管理体系，缔造发展愿景

根据 WSTS 的预测数据，2024 年全球半导体市场将实现复苏成长，预测增长 16.0%至约 6,112 亿美元，其中美洲、亚太（不含日本）地区复苏动力更强；2025 年全球半导体复苏劲头有望持续；全球模拟芯片 2024 年市场规模预计约为 791 亿美元，较 2023 年同比下降 2.7%，预期降幅明显收窄；预期 2025 年全球模拟芯片市场有望重回增长，复苏可期。从国内情况来看，我国是全球最大的集成电路需求市场，随着全球供应链重构的趋势下，国产集成电路领域自主可控、进口替代的潜力巨大。近年来，国家政策对集成电路行业的支持力度也不断加大，推动了集成电路国产化替代趋势，促进了产业链的成熟和行业健康发展。

从公司发展战略角度而言，公司管理层具备较强的产业洞察力，能够从产业变化中抓住关键机会，参与到具备发展潜力的商业机遇中。面对国产替代、自主创新和终端产业进步的三重驱动下，公司凭借敏锐的市场洞察力，坚持以研发创新为核心驱动力，强化解决方案的技术自主性、方案完整性与需求适配性，快速响应市场变化，抓稳国产化和产业升级的重要机遇，深耕国内市场。

从国内半导体的发展领域而言，公司除了继续完善消费电子领域的产品布局，树立市场领导地位，伴随着国内推动汽车、工业领域的国产自主可控的力度逐步加强，市场潜力巨大，公司还会持续布局汽车电子、泛工业领域的产品矩阵，寻求研发技术水平的快速延伸与进步，致力于为汽车和工业领域的客户提供更可靠稳定、更具性价比、更创新的电源管理解决方案，助力国产自主创新。

公司逐步完善和搭建高效的管理体系，致力于建立更完备的管理运营制度。通过优化内部流程和引入先进的管理工具，公司不断提升运营效率和决策能力，确保各项业务的有序推进和资源的合理配置。同时，公司业务发展也离不开高质量的团队建设和人才培养，以上海总部为管理、研发、销售中心，深度布局成都、北京、深圳、珠海等国内人才聚集的核心城市，凭借公司的行业领导地位以及完善的人才激励、培养体系，吸引本地化人才，进一步增强实力。着眼未来，公司重视“出海”新机遇，将推动管理层和员工共同提升国际化的专业素养和管理能

力，逐步搭建国际化的运营体系，强化国际化视野，加强海外布局，挖掘海外优质新客户，吸引国际化人才，以实现公司全球化发展的期许。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

2024 年 1-6 月，公司研发支出变化情况如下：

单位：元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	变化幅度（%）
费用化研发投入	182,671,361.19	124,719,646.80	46.47
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	182,671,361.19	124,719,646.80	46.47
研发投入总额占营业收入比例（%）	14.61	18.88	减少 4.27 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	

2024 年 1-6 月，公司研发支出增加主要系公司加大研发投入，报告期内研发人员薪酬、研发材料等投入较上年同期大幅增长所致。

（二）研发进展情况

2024 年 1-6 月，公司新增一项核心技术，为 Q 值检测技术，该技术已应用于公司产品，公司核心技术全部为自主研发。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计获得专利 100 项，报告期内公司新增授权发明专利 11 项。

项目	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	50	11	313	100
实用新型专利	2	-	2	-
外观设计专利	1	-	1	-
软件著作权	-	-	-	-
其他	-	-	61	61
合计	53	11	377	161

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,397,533,055.71 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	2,540,564,700.00
减：承销保荐费用	139,509,433.96
实际使用补充流动性资金	540,606,126.54
置换先期投入的自筹资金	51,365,538.11
置换先期以自有资金支付的发行费用	5,671,476.41
支付发行费用	20,546,687.94
支付募投项目款项	422,100,706.81
手续费	7,458.22
加：利息收入	36,775,783.70
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,397,533,055.71

公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 6 月 30 日，南芯科技的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

姓名/名称	类别	直接持股数量（万股）
阮晨杰	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	7,278.06

姓名/名称	类别	直接持股数量（万股）
卞坚坚	董事、副总经理	-
刘敏	董事、副总经理	-
简德明	董事	-
WENJIJIN	董事	-
陈刚	董事	-
曾晓洋	独立董事	-
CHRISTINE XIAOHONG JIANG	独立董事	-
林萍	独立董事	-
韩颖杰	监事	-
程潇	监事	-
杨申华	监事	-
赵熹	财务负责人	-
梁映珍	董事会秘书	-

注：截至 2024 年 6 月末，根据 2023 年 7 月 1 日《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，赵熹先生获授限制性股票数量 31.86 万股，但上述限制性股票尚未归属。

截至 2024 年 6 月 30 日，南芯科技的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的南芯科技股份均不存在质押、冻结及减持情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

贾兴华

贾兴华

杨鑫强

杨鑫强

